

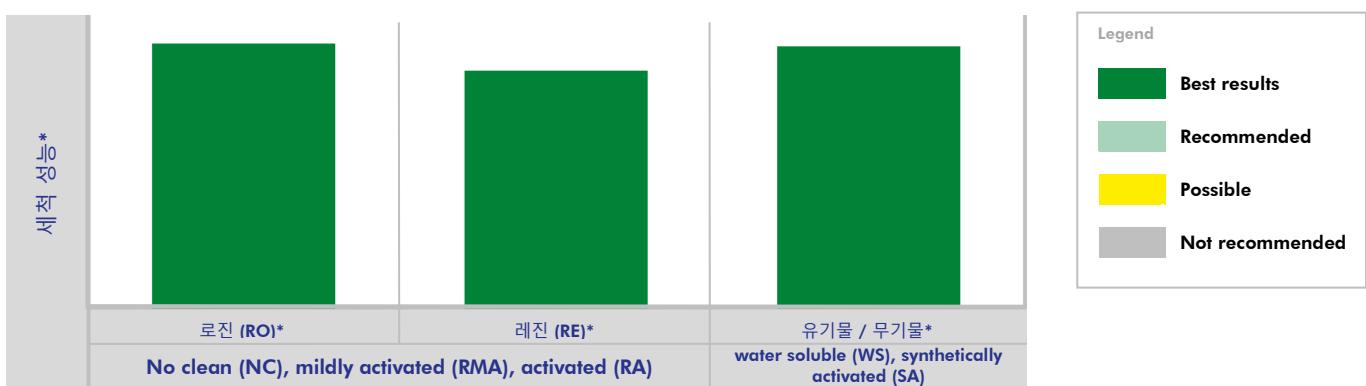
VIGON® A 201

스프레이 분사 방식을 위한 수계기반의 알칼리성 세척 용액



VIGON® A 201 은 미세한 공간도 세척할 수 있도록 하는 스프레이 분사 방식 공정에서 뛰어난 세척 성능을 자랑합니다. MPC® 기술을 기반으로 한 세척액은 특히 유연 뿐만아니라 무연의 No-Clean 솔더 페이스트의 잔여물을 제거하는 데 적합하며, 다른 첨가제 없이도 세척 후 깨끗한 솔더 조인트를 확인할 수 있습니다. 또한, VIGON® A 201 은 플립칩과 CMOS 에 있는 점성이 있는 잔여물들을 제거하며, 다이 부착 후 파워 LED 표면의 플럭스 제거에도 적합합니다.

적용 범위 – PCBA 디플럭싱(Defluxing)



* J-STD-004

다른 세척제와 비교 시 이점

- BGAs, 플립칩, 01005 와 같은 Low standoff 부품에서도 성공적인 세척을 보장합니다.
- 특히 무연의 No-Clean 솔더 페이스트 세척에 효과적입니다.
- 다른 추가 첨가물 없이 세척 후 부품 위에 깨끗한 솔더 조인트를 보장합니다.
- 높은 bath 로딩 용량으로 bath 수명이 연장되고, 유지 보수 비용 및 세척 부품당 비용을 절약할 수 있습니다.
- 쉽게 린스 가능하며, 표면에 잔사가 남지 않습니다.
- 플립칩과 CMOS 위에 점성이 있는 모든 플럭스를 제거하여 보이드(Void) 없는 언더필을 제공하고, 이미지 해상도를 개선합니다.
- 다이 부착 후, 최적의 플럭스 제거로 와이어 본딩 품질이 높아지고, 파워 LED 빛의 전환 및 수명이 증가됩니다.

공정 단계

세척 공정	부품	1. 세척	2. 린스	3. 건조
Spray-in-air (스프레이 분사) (inline & batch)	PCBAs, (플립칩 / CMOS, 파워 LEDs)	VIGON® A 201	DI-water	Hot air